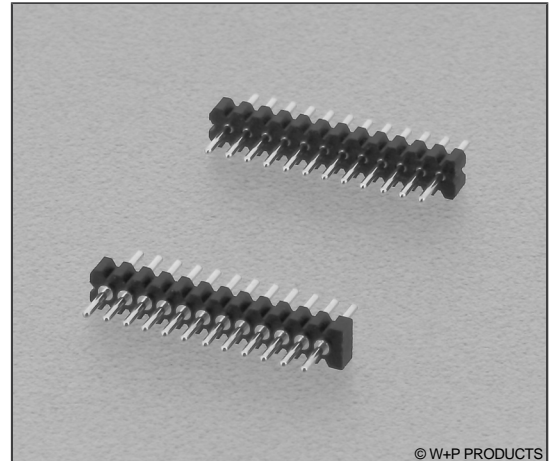


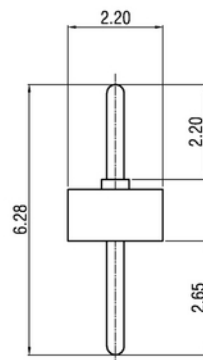
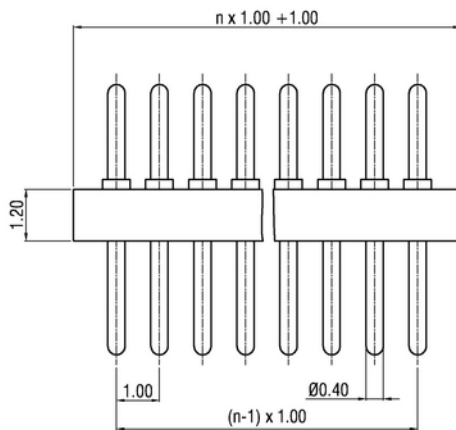
Präzisions-Stiftleisten RM 1,00mm, gerade, 1-reihig Precision Pin Headers, 1.00mm Pitch, Straight, Single Row

Technische Daten / Technical Data

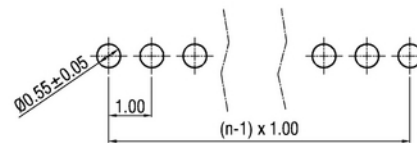
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Rundkontakt Ø0,40mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Ø0.40mm round contact, copper alloy</i>
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 10 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	500 V RMS
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V RMS</i>
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
<i>Voltage Rating</i>	<i>100 V RMS / 150 V DC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-55 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave or reflow soldering</i>



Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
7090



Recommended PCB Layout



Series

723

Contacts*

008

002-050

Plating*

10

10 Vergoldet 0,25µm

0.25µm gold plated

50 Verzinkt

Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

